证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-053

合肥晶合集成电路股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2022年5月9日出具的《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954号）同意，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）501,533,789股。公司每股发行价格19.86元，募集资金总额为9,960,461,049.54元，扣除发行费用236,944,589.63元后，募集资金净额为9,723,516,459.91元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月26日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	9,723,516,459.91
加：未置换的以自有资金支付的发行费用（印花税）	2,431,486.99
加：利息收入扣除银行手续费净额	116,652,830.14
减：募集资金投资项目支出(a+b+c)	8,231,579,564.05
其中：直接投入募集资金项目的金额(a)	5,063,492,999.60
以募集资金置换预先投入项目的自筹资金的金额(b)	2,075,224,554.41
使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额(c)	1,092,862,010.04
减：节余资金永久补充流动资金	344,437,420.65
减：超募资金永久补充流动资金	60,000,000.00
减：超募资金回购公司股份	164,520,697.56
减：报告期末尚未赎回的用于现金管理的闲置募集资金	500,000,000.00
截至2025年6月30日募集资金专户应有余额(d)	542,063,094.78
截至2025年6月30日募集资金专户实际余额(e)	542,063,094.78
差异(d-e)	0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关规定的要求制定了《合肥晶合集成电路股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以及募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额	备注
合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	20000515418466600000057	167,610,905.12	
合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	20000515418466600000164	362,275,595.80	
中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	181267662902	3,275,292.58	
中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行	12181001040035296	6,466,871.14	
招商银行股份有限公司合肥分行	551904996610555	0.00	2024年7月17日销户
兴业银行股份有限公司合肥望江东路支行	499050100100419345	0.00	2024年7月19日销户
中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010129200389609	0.00	2024年5月17日销户
中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002618	2,434,430.14	
合计		542,063,094.78	/

注：募集资金存放专项账户的存款余额不包含报告期末尚未赎回的用于现金管理的闲置募集资金500,000,000.00元。详见本专项报告“三、半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本专项报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年5月31日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，使用不超过人民币20亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）。

公司于2025年4月28日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，使用不超过人民币15亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为670,776,197.70元，其中170,776,197.70元为协定存款，500,000,000.00元为券商收益凭证。报告期购买的券商收益凭证明细如下：

单位：人民币亿元

受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	是否赎回
国元证券股份有限公司	国元证券元聚利81期浮动收益凭证	保本浮动收益	2.00	2024/7/10	2025/1/6	是
国元证券股份有限公司	国元证券元聚利82期浮动收益凭证	保本浮动收益	2.00	2024/7/10	2025/1/6	是
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈37期浮动收益凭证	保本浮动收益	1.00	2024/7/31	2025/2/5	是
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈38期浮动收益凭证	保本浮动收益	0.50	2024/8/7	2025/2/11	是
中国中金财富证券有限公司	中金公司金泽鑫动195号收益凭证	保本浮动收益	0.50	2024/10/18	2025/1/20	是
中国中金财富证券有限公司	中金公司金泽鑫动196号收益凭证	保本浮动收益	0.50	2024/10/18	2025/4/21	是
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈62期浮动收益凭证	保本浮动收益	1.00	2024/10/31	2025/5/6	是
国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享定制609期	保本固定收益	1.00	2025/1/8	2025/5/27	是
国元证券股份有限公司	国元证券元聚利116期	保本浮动收益	1.00	2025/1/8	2025/5/27	是
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节添利系列173期	保本浮动收益	1.00	2025/1/9	2025/5/27	是
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈77期	保本浮动收益	0.50	2025/1/24	2025/5/26	是
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈79期	保本浮动收益	1.00	2025/2/10	2025/5/26	是
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈80期	保本浮动收益	0.50	2025/2/14	2025/5/26	是
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈108期	保本浮动收益	0.50	2025/5/13	2025/8/12	否
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍166号	保本浮动收益	0.50	2025/5/23	2025/11/24	否
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍167号	保本浮动收益	0.50	2025/5/23	2025/11/24	否
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍173号	保本浮动收益	1.00	2025/5/30	2025/12/1	否
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍174号	保本浮动收益	1.00	2025/5/30	2025/12/9	否
国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享定制632期	保本固定收益	1.30	2025/5/29	2025/9/1	否
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节添利系列183期	保本浮动收益	0.20	2025/5/30	2025/11/26	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、募投项目“40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”结项

公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”予以结项，并将节余募集资金35,323.63万元（未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，实际节余资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充公司流动资金。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。

截至2025年6月30日，公司尚未将节余募集资金从募集资金存放专项账户转出。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

2023年6月21日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目部分款项，再以募集资金等额置换。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-006）。

截至2025年6月30日，公司使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式累计支付了募投项目所需资金共计1,197,066,617.76元，以募集资金1,092,862,010.04元进行了等额置换，剩余104,204,607.72元待置换。

除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，董事会同意本次终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”，并将该项目拟投入募集资金35,595.58万元（含现金管理收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准）变更投向至其他募投项目“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”，并授权公司管理层及其授权人士在股东会审议通过本次事项后办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项已于2025年5月28日经公司2024年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》（公告编号：2025-002）、《晶合集成2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-030）。

截至2025年6月30日，变更募投项目具体情况详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：

募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日

单位：人民币元

募集资金总额（扣除发行费用后）			9,723,516,459.91			半年度投入募集资金总额（实际支付口径）					393,591,013.44	
变更用途的募集资金总额			350,000,000.00			已累计投入募集资金总额（实际支付口径）					8,456,100,261.61	
变更用途的募集资金总额比例			3.60%									
承诺投资项目	已更目合更（如有）	变项，部变	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期投进(%)=(4)(2)/(1)	项达可用态期	本年度实现的效益	是否达到计效益	项可性否大	目行是发重变化
28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）	否		600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	37,771,916.88	438,063,644.35	-161,936,355.65	73.01	2025年底	不适用	不适用		否
微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）	是		350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	终止	不适用	不适用	不适用	是
40纳米逻辑芯片平台研发项目	否		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	99,640,759.99	1,176,243,549.77	-323,756,450.23	78.42	已结项	不适用	不适用	不适用	否
28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目注2	是		2,450,000,000.00	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	256,178,336.57	2,336,061,437.68	-463,938,562.32	83.43	2025年底	不适用	不适用	不适用	否
收购厂房及建设补充流动资金	否		3,100,000,000.00	3,100,000,000.00	3,100,000,000.00	0.00	2,763,936,719.17	-336,063,280.83	89.16	已结项	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动及偿还贷款	否		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	1,517,274,213.08	17,274,213.08	101.15	已结项	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动（如有）	否		0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金回购公司股份	否		0.00	163,516,459.91	163,516,459.91	0.00	164,520,697.56	1,004,237.65	100.61	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—		9,500,000,000.00	9,723,516,459.91	9,723,516,459.91	393,591,013.44	8,456,100,261.61	-1,267,416,198.30	86.97	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明			详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见本专项报告“三、半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用											
募集资金结余的金额及形成原因			详见本专项报告“三、半年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。											
募集资金其他使用情况			详见本专项报告“三、半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。											

注1：“截至期末累计投入金额”包含：直接投入募集资金项目的金额；以募集资金置换预先投入项目的自筹资金金额；使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额；超募资金永久补充流动资金金额，超募资金回购公司股份金额。

注2：公司终止“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”并将该项目募集资金投向变更至“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”，此处“调整后投资总额”不含“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”募集资金实际转出时的利息收入。

附件2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的实现的效益	是否达到预计效益	变更项目可行性是否发生重大变化
28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目	微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	256,178,336.57	2,336,061,437.68	83.43	2025年底	不适用	不适用	否
合计	—	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	256,178,336.57	2,336,061,437.68	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		受主轴产品研发策略和市场需求变化的影响，公司从市场需求、技术投入、投资收益以及成本控制等多个维度重新对募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”进行评估，认为该项目效益相较于最初预期出现了明显的降低趋势，公司决定整合研发资源并聚焦于公司主力产品，将更多研发力量投向效益更好的研发项目。28纳米逻辑及OLED芯片在市场上展现出巨大的需求潜力，并且公司“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”的开发进展顺利，目前已取得了良好的阶段性成果，公司期望通过扩大投资额，加快推动28nm产品的工艺精进及效能提升，以满足客户日益增长且不断变化的需求。鉴于上述情况，公司经慎重考虑决定终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”，并将该项目募集资金变更投向至其他募投项目“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”，增加“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”的投资总额。本次变更募投项目有利于更快实现效益，拓展产品的应用领域，使公司在激烈的市场竞争中占据更有利的地位，符合公司实际经营需要，具有合理性和必要性。 公司于2024年12月30日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，董事会同意本次终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”，并将该项目拟投入募集资金35,595.58万元（含现金管理收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准）变更投向至其他募投项目“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”，并授权公司管理层及其授权人士在股东会审议通过本次事项后办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项已于2025年5月28日经公司2024年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》（公告编号：2025-002）、《晶合集成2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-030）。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-055

合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2025年8月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年8月22日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长蔡国智召集并主持，应参加本次董事会会议的董事9名，实际参加本次董事会会议的董事9名，全体监事列席会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

同意取消公司监事会、变更经营范围及修订《公司章程》，提请股东会授权公司管理层或其授权人士办理变更经营范围以及修订《公司章程》涉及的变更登记及备案等具体事宜。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。

（二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

同意根据最新的法律法规，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定、修订。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案中《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》已经第二届董事会第十二次审计委员会审议通过，部分公司治理制度尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。

（三）审议通过《关于补选董事及独立董事、调整董事会专门委员会名称及组成的议案》

同意提名邱文生先生为第二届董事会非独立董事候选人；提名陈铤先生为公司第二届董事会独立董事候选人；任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。并同意调整公司第二届董事会专门委员会名称及组成。

1、选举邱文生先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

2、选举陈铤先生为第二届董事会独立董事候选人

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

3、调整公司第二届董事会专门委员会名称及组成

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

非独立董事及独立董事候选人资格已经第二届董事会第三次提名委员会审议通过，补选非独立董事和独立董事事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于补选董事及独立董事、调整董事会专门委员会名称及组成的公告》（公告编号：2025-046）。

（四）审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

经审议，董事会同意，为深化公司全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，多元化公司融资渠道，进一步提升公司核心竞争力，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。

公司本次发行并上市事宜需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府部门、监管机构或证券交易所的备案、批准和/或核准。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经第二届董事会第六次战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》（公告编号：2025-049）。

（五）审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

公司本次发行并上市的具体方案如下：

1.发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的H股，均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1元。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

2.上市地点及发行时间

本次发行的H股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。公司将在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由股东会授权董事会及其授权人士根据国际资本市场状况、境内外监管部门的审批、备案进展情况及其他相关情况决定。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

3.发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则（或其豁免）于美国境内向合格机构投资者进行的发售；和/或(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行；和/或(3)其他境外合格市场的发行。

具体发行方式将由股东会授权董事会及其授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况确定。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

4.发行规模

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低公众持股比例、最低自由流通比例规定或要求（或获得豁免）的前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模，本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前），并授予国际承销商（可由整体协调人全权及绝对酌情行使）或其代表根据当时的市场情况，选择不超过前述H股发行股数的15%的超额配售权。最终发行数量、发行比例由股东会授权董事会及其授权人士根据相关法律法规、交易所规则、境内外监管机构批准/备案及市场情况确定。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

5.定价方式

本次发行的发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，按照国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据本次发行并上市时国内外资本市场情况、参照可比公司在国内外市场的估值水平，采用市场化定价方式，由股东会授权董事会及其授权人士和整体协调人（为其本身及代表承销商）共同协商确定。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

6.发行对象

本次发行的对象为符合相关条件的参与香港公开发售的香港公众投资者、参与国际配售的国际投资者、依据境内相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者（QDII）及境内经批准的或者法律法规允许的其他可以进行境外投资的投资者。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

7.发售原则

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。香港公开发售部分将根据认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而有所不同，但应严格按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）指定（或获豁免）的比例分配。在适当的情况下，配发股份也可通过抽签方式进行，即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。公开发售部分的比例将按照《香港上市规则》以及香港联交所刊发的《新上市申请人指南》规定的机制厘定，并将按照其规定的超额认购倍数设定“回拨”机制（如适用）。如设定“回拨”机制，公司也可以根据《香港上市规则》、《新上市申请人指南》和发售时的具体规模向香港联交所申请“回拨”机制的豁免。国际配售部分占本次发行的比例须按照《香港上市规则》以及《新上市申请人指南》的规定而厘定，并将根据最终确定的香港公开发售部分比例（经回拨后，如适用）来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单并充分考虑各种因素来决定，包括但不限于：投资者下单的总量、总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者后市行为的预计等。在国际配售分配中，在符合有关法律法规及香港联交所规则要求的前提下，原则上将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资者（如有）和机构投资者。在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，本次发行并上市的相关公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司依据《香港上市规则》及香港法下第32章《公司(清盘及杂项条文)条例》的要求刊发正式H股招股说明书后，方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约（基石投资者（如有）除外）。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

8.承销方式

本次发行由整体协调人组织承销团承销。具体承销方式由股东会授权董事会及其授权人士及根据国际资本市场状况等情况和境内外监管部门审批进展及其他相关情况确定。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经第二届董事会第六次战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

经审议，董事会同意，根据相关法律法规的规定，在取得本次发行并上市的有关批准、备案后，公司将在董事会及其授权人士决定的日期，根据正式刊发的H股招股说明书所载条款及条件，向符合资格的投资者发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市。公司在本次发行并上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司，成为在上海证券交易所和香港联交所两地上市的公众公司。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经第二届董事会第六次战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

经审议，董事会同意，公司本次发行并上市所得的募集资金在扣除发行费用后，将用于（包括但不限于）：工艺技术研发升级、制程平台产品研发、智能工厂改造等项目和营运资金及一般用途。同时，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士在经股东会批准的募集资金用途范围内根据上市申请核准和备案过程中项目审批及投资进度、监管机构相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整（包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划，对募集资金投资项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整，确定募集资金项目的投资计划进度，签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同，根据招股说明书的披露确定超募资金的用途（如适用）等）。具体募集资金用途及投向计划以公司H股招股说明书最终版的披露为准。

9、根据有关政府部门、监管机构或证券交易所的要求及有关批准或备案文件，对股东会审议通过的与本次发行并上市相关的决议内容作出相应修改，但依据相关法律法规和监管规则必须由股东会审议的修改事项除外。

10、授权董事会根据需要授权有关人士具体办理与本次发行并上市有关的全部事务，签署及在其可能酌情认为合适时，对本次发行并上市有关法律文件作出修改、调整或补充并批准相关事项。

11、授权董事会及其授权人士，向包括香港公司注册处在内的政府机构及监管机关递交及收取与本次发行并上市有关的文件（包括但不限于变更公司秘书，公司在香港的主要营业地址、公司在香港接受法律程序文件及通知的代理（如需）的相关文件等），并办理有关签署文件的批准、登记或备案手续及必要或合宜的其他事宜。

12、办理本次发行并上市完成后所发行股份在香港联交所上市流通事宜以及遵守和办理《香港上市规则》所要求的其他事宜。

13、上述授权应包括在董事会及其授权人士可能酌情认为合适时，对有关内容进行修改、调整或补充的权利、签署任何有关的文件以及向任何相关部门进行申请的权利。

14、在董事会及其授权人士已就本次发行并上市作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤，并具体办理与本次发行并上市有关的其他事务。

15、授权期限为本议案经股东会审议通过之日起24个月。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次发行并上市的批准文件，则授权有效期自动延长至本次发行并上市相关手续办理完毕之日。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经第二届董事会第六次战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于确定董事会授权人士全权处理与本次发行H股并上市有关事项的议案》

经审议，董事会同意，在获得股东会批准《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》（以下简称“《授权议案》”）等与本次发行并上市有关议案的基础上，进一步授权公司董事长、董事会秘书作为董事会授权人士（可转授权）行使该议案授予的权利，具体办理本次发行并上市有关的议案所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发行并上市有关的事务，授权期限与《授权议案》所述授权期限相同。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经第二届董事会第六次战略委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意，为兼顾公司现有股东和未来H股股东的利益，在扣除公司于本次发行并上市之前根据中国法律、法规及《公司章程》的规定、并经公司股东会审议批准的拟分配股利后，公司本次发行并上市前的滚存未分配利润由本次发行并上市后的全体新老股东按照其于本次发行并上市后的持股比例共同享有。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经第二届董事会第十二次审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于就公司发行H股股票并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

基于本次发行并上市需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《香港上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，同意对本次董事会修订后的《公司章程》及相关议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《合肥晶合集成电路股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》